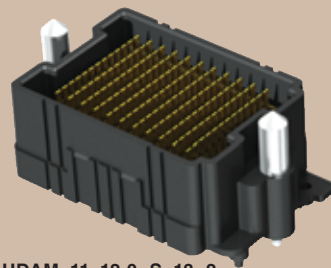


(2,00mm) .0787"

HDAM, HDAF 系列



HDAM-11-12.0-S-13-2



HDAF-11-08.0-S-13-2

# 加高紧固型高密度阵列

HDAM 配接:  
HDAFHDAF 配接:  
HDAM

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览  
www.samtec.com?HDAM,  
www.samtec.com?HDAF

绝缘体材料:  
黑色液晶聚合物  
触点材料:  
铜合金

额定电流:  
环境温度 80°C 时为 2.3A  
工作温度范围:  
-55°C 至 +125°C

电镀:  
在 50μ" (1.27μm)  
的镍上镀金或锡  
触点电阻:  
19 mΩ 最大

工作电压:

200 VAC

配接次数:

100

符合 RoHS 规范要求:

是

可无铅焊接:

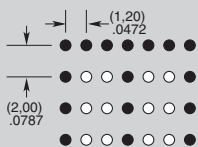
是



FILE NO. E111594



## 差分应用



| 阵列    | 对数* |
|-------|-----|
| 11x13 | 44  |
| 15x13 | 60  |
| 23x13 | 92  |

\*2:1 S:G 比例

## 还提供

锡铅焊接。  
请致电 Samtec。

注: 提供其他镀金选项。  
请联系 Samtec。

注: HD Mezz 是 Molex  
Incorporated 的商标

注: 有些长度、式样和选项为  
非标型, 不可退换。

| HDAM | 每排<br>引脚数     | 引线<br>式样           | 电镀<br>选项                                               | 排数  | 焊接<br>类型                                            | 其他<br>选项        |
|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
|      | -11, -15, -23 | 从图表中<br>指定<br>引线式样 | -S<br>= 触点区域镀<br>30μ" (0.76μm)<br>的金,<br>焊尾和<br>焊接片镀雾锡 | -13 | -2<br>= 无铅<br>锡阵列<br>95.5% 锡/<br>3.8% 银/.7% 铜<br>焊接 | -P<br>= 取<br>放垫 |

每排  
引脚数  
x  
(2,00)  
.0787  
+  
(16,06)  
.632

每排  
引脚数  
x  
(2,00)  
.0787  
+  
(11,55)  
.455

| 引线<br>式样 | A               |
|----------|-----------------|
| -12.0    | (14,41)<br>.567 |
| -17.0    | (19,41)<br>.764 |

• 整体式导柱

| 35mm 堆叠高度 | 在 3dB 插入损耗的额定值*     |
|-----------|---------------------|
| 单端信号      | 9.0 GHz / 18.0 Gbps |
| 差分对信号     | 9.0 GHz / 18.0 Gbps |

\*数据基于使用 Final Inch® 设计进行的模拟。

如需完整测试数据, 请浏览 [www.samtec.com?HDAM](http://www.samtec.com?HDAM),  
[www.samtec.com?HDAF](http://www.samtec.com?HDAF) 或联系 [sig@samtec.com](mailto:sig@samtec.com)

| HDAF | 每排<br>引脚数     | 引线<br>式样           | 电镀<br>选项                                               | 排数  | 焊接<br>类型                                            | 其他<br>选项        |
|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
|      | -11, -15, -23 | 从图表中<br>指定<br>引线式样 | -S<br>= 触点区域镀<br>30μ" (0.76μm)<br>的金,<br>焊尾和<br>焊接片镀雾锡 | -13 | -2<br>= 无铅<br>锡阵列<br>95.5% 锡/<br>3.8% 银/.7% 铜<br>焊接 | -P<br>= 取<br>放垫 |

每排  
引脚数  
x  
(2,00)  
.0787  
+  
(11,55)  
.455

每排  
引脚数  
x  
(2,00)  
.0787  
+  
(17,92)  
.706

| 引线<br>式样 | A               |
|----------|-----------------|
| -08.0    | (10,51)<br>.414 |
| -18.0    | (20,51)<br>.807 |

• 整体式导柱